

北京屹唐半导体科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，围绕持续优化公司经营和加快创新发展、增强投资者回报、强化投资者沟通、进一步规范公司治理等方面，多措并举进一步提高公司发展质量，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

一、聚焦主业，以创新引领公司高质量发展

受益于人工智能相关应用的爆发式需求带动的高性能计算与数据中心基础设施的持续投资以及汽车电子、工业控制等新兴应用对半导体市场需求的多元化支撑，全球半导体市场规模高速增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测数据，2025 年全球半导体市场规模预计将达到 7,720 亿美元，同比增长 22.5%，展望 2026 年，全球半导体市场规模有望进一步增长至超过 9,750 亿美元，同比增长超过 25%，首次逼近万亿美元大关。半导体设备行业作为集成电路产业的基石，正处于市场规模增长与技术迭代加速的关键发展阶段。根据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）的统计数据，全球半导体设备市场（含前端晶圆制造及后端封测设备）在 2025 年达到创纪录的 1,351 亿美元，较 2024 年增长 15.4%；SEMI 预计 2026 年全球半导体设备市场规模将进一步扩大至 1,450 亿美元，同比增长 7.3%。

公司凭借在集成电路前道设备领域 30 余年的自主研发经验和技術积累，形成了双晶圆真空反应腔设计、双晶圆反应腔真空整合传输设备平台设计、电感耦合远程等离子体源设计、远程等离子体源电荷过滤装置、晶圆双面辐射加热快速热退火技术、晶圆表面局部温度均匀度调节技术等核心技术。公司目前已形成包括干法去胶设备、快速热处理设备和干法刻蚀及等离子体表面处理设备在内的三类具有国际竞争力的成熟集成电路设备产品线。公司是同时具备等离子体和晶圆

热处理国际领先技术的集成电路专用设备公司，高产能真空晶圆传输设备平台可与公司各种反应腔体工程技术衔接，将助力公司加速进入一体化半导体设备市场，发展潜力巨大。

公司 2025 年营业收入约 50.76 亿元，同比增长 9.57%；干法去胶设备销售收入基本保持稳定，市场占有率位居全球第二；快速热处理设备与干法刻蚀及等离子体表面处理设备销售收入实现快速增长，快速热处理设备销售收入 14.81 亿元，同比增长 32.85%，干法刻蚀及等离子体表面处理设备销售收入 7.54 亿元，同比增长 30.73%。2026 年，公司将继续聚焦主业，做深做精主营设备产品，同时加快开发新品类、新产品，坚持自主创新，不断增强公司产品的市场竞争力，并持续优化公司运营管理，促进公司高质量、稳健、快速的发展，保持公司相关产品在全球以及国内集成电路设备行业的领先地位。具体包括以下方面：

（一）持续深耕主业，增强核心竞争力

公司将通过持续研发投入，对现有干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备持续开展技术改进升级，不断提升产品的竞争力，保持产品先进性。目前，公司在三大产品线上均已取得新的进展：（1）干法去胶设备方面，公司开发推出了新一代先进干法去胶设备 Optima[®]，该等离子体干法去胶设备系列产品可满足各类制程工艺需求，工艺效果优异，具备颗粒污染低、大规模量产综合持有成本低等卓越性能，该设备已通过关键客户量产验证并获得客户重复量产订单，客户需求也在持续增长。（2）快速热处理设备方面，公司借助在高温快速热处理、等离子体源及超高产出设备平台等领域的技术积累，已开展新的研发工作，包括开发新一代常压快速热处理设备以提高现有设备性能，使其拥有更强的市场竞争力；开发先进低压快速热处理设备以全面覆盖各类制程需求；开发新型快速热处理设备，包括具备低热预算且具有选择性加热的新一代快速热处理设备以及集成多项连续工艺流程的快速热处理一体化设备。其中部分项目已完成产品开发，处于客户进行量产验证过程中。（3）干法刻蚀及等离子体表面处理设备方面，公司开发推出了新一代先进干法刻蚀设备 RENA-E[®]，该等离子体刻蚀机可以对离子能量和离子密度进行独立控制，具备刻蚀速度快、晶圆器件等离子体损伤小、器件性能表现优异、反应腔损耗品寿命长等各项卓越性能，还可以高效

应对介质材料和金属材料的复杂膜层刻蚀。该设备已通过关键客户量产验证并获得客户重复量产订单，客户需求也在持续增长。(4) 公司开发的先进等离子体表面处理和材料改性设备 Escala®利用专利技术产生高浓度化学反应自由基，在低热预算下有效改善各种薄膜材料的性质和性能，广泛应用于存储器和逻辑半导体制造中金属薄膜电阻率降低，裂缝修复，增强钨薄膜选择性沉积，增强可流动化学气相沉积介质薄膜致密度等。该设备已通过关键客户技术验证，并实现重复量产订单，公司将持续推进该设备在更多客户进行量产验证。除了上述已量产的新产品之外，为了更好地满足国内外客户对于干法刻蚀及等离子体表面处理设备的广泛需求，进一步提升公司在干法刻蚀及等离子体表面处理设备领域的可服务市场规模，公司目前已开展多项新型干法刻蚀及等离子体表面处理设备研发项目，部分项目已完成产品研发，即将开展客户端验证。

2026 年，公司将以更具创新性的产品、更高性价比、更低成本为方向，在现有三大产品线的基础上，推动高性能高产出的新型去胶设备、新一代常压快速热处理设备、先进低压快速热处理设备、新型快速热处理设备、高产能刻蚀设备系列等新产品尽快完成研发并推向客户端验证。

(二) 坚持核心技术自主原创，不断加大研发投入力度

公司坚持自主原创和正向研发的理念，始终以核心技术的自主创新引领公司研发工作的开展，并持续加大研发投入力度。2025 年公司研发总投入约 7.39 亿元，同比增长 3.03%。2025 年公司新增专利申请 61 项，其中发明专利 61 项，占比 100.00%；公司新增授权专利 85 项，其中发明专利 84 项，占比 98.82%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已申请专利 739 项，其中发明专利 737 项，占比 99.73%；已获授权专利 505 项，其中发明专利 503 项，占比 99.60%。2025 年，公司已申请软件著作权 14 项，其中已获登记的软件著作权 6 项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工总数 1,270 人，其中研发人员 397 人，占公司员工总数的 31.26%，其中国内研发人员 276 人，占研发人员总数的 69.52%。

(三) 深入推进供应链本土化，加快产业链布局

公司重视提升集成电路设备及核心零部件供应链的安全性，并积极拓展和协同上游供应商开展技术合作，共同推动相关零部件的技术进步，从而加快相关零

部件项目的本土化进程，保证产品和技术的自主可控及供应链安全。

2026年，公司将继续关注集成电路产业链的外延发展，持续加大力量参与培育本土供应链，围绕干法去胶、干法刻蚀及等离子体表面处理设备、热处理设备等集成电路设备需求，重点培育关键零部件的本土供应商，带动产业链上游协同发展。

（四）内生增长与外延并购并重，加快公司发展

公司致力于成为国际领先的集成电路设备公司，将持续为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路专用设备。在未来的发展中，公司将坚持植根中国的国际化经营策略，建设国际化的研发和管理团队，并实现合作协同，服务全球客户，同时持续加大在国内的投入，提高国内制造基地生产能力、服务能力和研发能力，更好满足国内外客户需求。

公司将以客户需求为导向进行研发活动及业务拓展，基于公司的技术积累和技术优势，采用差异化的研发策略，以研发驱动业绩增长，保持、提升公司在干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备领域的产品优势地位及市场竞争力，持续开发推出新产品，扩大产品组合及可服务市场规模，积极开拓国内外集成电路制造厂商新客户，提高市场份额。

公司也将结合自身战略目标及发展规划，关注集成电路设备上下游零部件股权投资机会及其他设备领域的优质并购标的投资机会，借助外延式并购扩大产品及市场覆盖，实现规模效应，进而增强公司的综合实力、提升公司在国际集成电路设备领域的行业地位与影响力。

二、持续优化运营管理，保障上市公司经营业绩

公司设备产品在集成电路代工厂、逻辑芯片、存储芯片、专用芯片等制造领域已实现产业化应用，客户群体覆盖全球前十大芯片制造商和国内主流芯片制造商。凭借公司三大系列设备先进的产品性能、卓越的产品质量，公司营业收入保持持续增长的趋势，2025年度公司实现营业收入50.76亿元，同比增长9.57%；归属于上市公司股东的净利润达到6.71亿元，同比增长24.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达到5.41亿元，同比增长11.61%，盈利能

力持续增强。同时，公司高度重视运营管理能力的提升，通过组织管理人员培训、每周召开供应链本土化工作协调会等多种措施构建了降本增效、持续增强盈利能力的管理文化。

2026年，公司将继续深入优化现有采购、生产、物流、管理等内外部资源，进一步改善研发、采购和供应商管理、生产制造、物流、客户服务等各个环节和流程，通过提前布局前沿技术、优化完善供应商体系、推进精细化运营管理等措施，进一步提升企业管理水平，全面持续深化精细化管理，降低企业运营成本，不断提升经营业绩，保证公司持续高质量稳健发展。

三、重视股东投资回报，积极分享公司成长红利

公司高度重视股东的投资回报，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制。在制度层面，公司在《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对利润分配的基本原则、分配形式、现金分红条件和比例以及利润分配的决策程序等作出了详细规定。2026年，公司将积极落实以“投资者为本”的上市公司发展理念，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡，严格执行公司的利润分配政策，提升广大投资者的获得感。在符合相关法律法规以及《公司章程》的利润分配政策的前提下，结合公司战略规划、经营发展需要以及资金使用安排，坚持现金分红为导向，积极探索更多方式回报股东。

四、提升信息披露质量，建立多元化沟通体系

公司自上市以来按法律法规和公司相关制度的要求严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司的信息透明度。

（一）持续提升信息披露质量

2026年，公司将继续严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等发布的有关法律法规和公司相关信息披露管理制度，严谨、合规地开展信息披露工作，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告和临时公告等重大信息，为

股东进行投资决策提供信息基础。公司也将进一步提高信息披露内容的系统性、可读性和易理解性，在公司披露定期报告后适时发布可视化报告，并及时举行业绩说明会对定期报告内容进行解读，及时回应投资者提出的问题，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。

（二）构建多元化的投资者沟通体系

公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，积极搭建与投资者沟通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，通过公司官网投资者关系板块、上证 e 互动平台、投资者热线电话、投资者电子信箱、业绩说明会等多种渠道与投资者保持良好互动和沟通。

2026 年公司将进一步构建多渠道、多平台、多方式的投资者关系管理体系，将持续通过投资者热线电话、投资者电子信箱等渠道与投资者高效沟通，并及时回应上证 e 互动平台上投资者的提问，保障投资者能够通过多元化平台与公司进行顺畅交流；此外，公司也将组织投资者交流会、上市公司现场调研、业绩说明会等投资者交流活动，加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，使得广大投资者能够及时、公开、透明地了解公司运作和管理情况、经营状况、发展战略等情况，加深投资者对公司的了解和认知。

五、进一步完善公司治理体系，持续提升公司治理水平

完善的治理结构与高效的内部控制体系对于公司的长远发展至关重要，公司建立了由股东会、董事会、董事会各专门委员会和管理层组成的公司治理体系，以确保权力分配和职责划分的清晰性，决策的合理性，以及监督和管理的有效性，从而实现不同层级治理机构间的良性互动和平衡。公司坚决执行、落实独立董事制度和股东回报等相关制度、意见，积极推动《公司章程》《北京屹唐半导体科技股份有限公司股东会议事规则》《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会议事规则》《北京屹唐半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等 20 余项公司治理制度的更新与完善。

同时，公司保持对上交所、北京上市公司协会、中国上市公司协会等监管机构和自律组织发布的相关培训信息的关注，并及时组织董事、高级管理人员参加，

以提升董事、高级管理人员的合规意识、自律意识以及履职能力。2025 年度，公司董事、高级管理人员就 15 项培训合计参与 30 人/次。

2026 年，公司计划依据《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》，进一步明晰独立董事的职责和履职方式，定期对独立董事的独立性进行评估，充分发挥独立董事在公司治理中的关键作用。此外，公司还将加强董事会下属各专门委员会的建设和运行效率，并通过不断学习最新的证券市场法律法规，提高公司的科学决策和风险防范能力，进而推动公司治理水平的全面提升。

2026 年，为确保公司董事、高级管理人员了解最新的法律法规，提升其履职能力和合规知识储备，进而提升公司整体的规范运作水平，公司将根据相关信息公布的情况及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给董事和高级管理人员；另一方面，公司将组织董事、高级管理人员继续进行线上、线下学习，充分借助证监会、上交所、上市公司协会及其培训平台等资源，邀请公司保荐机构、常年法律顾问等中介机构就公司合规运作知识进行有针对性的培训，每人全年参加培训不少于 1 次。

六、压实“关键少数”责任，实现利益风险共享共担

2026 年，公司计划制定《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，更多地将高级管理人员薪酬架构与公司经营绩效挂钩，进一步增强高级管理人员与股东利益共享和风险共担。

公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行 2026 年度绩效考评，将高级管理人员薪酬结构更多地与公司经营业绩相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬结构与公司长远发展和股东利益相结合。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司的长期稳定发展。

七、持续评估完善行动方案，共同推动公司高质量发展

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦于主业，持续提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管

理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

八、其他说明及风险提示

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，该方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险，理性进行投资。

北京屹唐半导体科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日